STANDARD - LAGENAUFBAU HDI

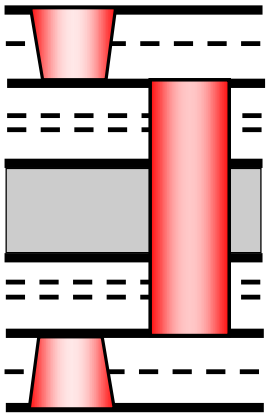
HDI06_1+4b+1_1,50_35

6 - Lagen

Kern: 0,93 mm Cu 35/35 µm

WE-Artikel Nr.:		**1 + 4B + 1**
KUNDE:		

WÜRTH ELEKTRONIK

LAGENBEZEICHNUNG KUNDE	LAGENBEZEICHNUNG WE	AUFBAU	BASIS-Material	CU	PREPREG ANZAHL/TYP	ENDDICKE [µm]	KUNDEN-FORDERUNG [µm]
1	TOP/VS		Folie	12 µm	1)	12	
					1 x 1080	**60**	
2	VSK1		Folie	9 µm		**35**	
					2 x 1080	**132**	
3	2			35 µm		**33**	
			0,930 mm			**930**	
4	3			35 µm		**33**	
					2 x 1080	**132**	
5	RSK1			9 µm		**35**	
					1 x 1080	**60**	
6	BOT/RS		Folie	12 µm	1)	12	

1) Endkupferdicke Außenlagen ca. 55 µm

Gesamtdicke Material:						1474	

Anmerkung: Werte für Prepreg sind Mittelwerte (der genaue Wert ist von den Leiterbildstrukturen abhängig)

MATERIALDICKE:	**1,50**	+/-	0,12	mm			Datum:	Bearbeiter:
DICKE über galv. Endoberfläche	1,59	+/-	0,15	mm				
DICKE über LSM incl.galv.-Kupfer	1,65	+/-	0,17	mm				
Kundenforderung:		+/-		mm	Messstelle:			

Erstellt am	von	Geprüft am	von	Freigegeben am	von	Revision		
05.01.2006	**S. Keller**	04.05.2006	M.Kress	05.01.2006		00	Seite:	14+